

月度市场报告

SEMI: 到2028年中国将占据全球芯片制造产能的42%

2025年9月刊

新汉科技

仅供内部使用

目录

本月重点	3
原厂动态	4
行业趋势	9
政策影响	12
高风险物料预警	12

本月重点

1. 意法半导体延长汽车 MCU 的供应保障
2. ADXL 系列出货困难
3. 三星再次调涨存储芯片价格
4. 镁光产能吃紧致使价格上涨 30%
5. SEMI: 到 2028 年中国将占据全球芯片制造产能的 42%
6. 《新跨大西洋贸易协议》影响报告

本报告每月发布一次，部分消息源自于我们供应商或客户的所见及所闻，部分消息来自于渠道直接或间接提供。本报告由新汉科技整理并做简单分析，并不代表新汉科技观点及立场，仅供参考与学习。网络消息繁杂，请大家注意甄别。

原厂动态

意法半导体延长汽车 MCU 的供应保障

意法半导体此次将 SPC58 汽车 MCU 的供应保障延长至 20 年，是对汽车行业长期发展需求的重要响应。汽车电子领域具有产品生命周期长的显著特点，尤其是整车厂的平台化设计往往需要 10 年以上的生命周期，而零部件供应商的产品支持周期则需更长。ST 将 SPC58 系列的供应保障延长至 2038-2041 年，能够为汽车制造商提供更稳定的供应链保障，降低因芯片停产导致的设计变更和成本增加风险。从产品布局来看，SPC58 系列覆盖了通用和高性能多个应用场景：通用系列适用于智能网关、车身控制等领域，高性能系列则瞄准动力总成电气化和底盘安全等关键应用，这种全面的产品组合搭配长期供应承诺，有助于 ST 巩固在汽车 MCU 市场的竞争力。对于汽车行业客户而言，这种长期供应承诺有助于他们在产品设计初期就制定更长远的规划，无需频繁为芯片替代方案担忧，从而更专注于技术创新和产品性能提升。

ADXL 系列出货困难

ADI ADXL 系列的 MEMS 由于产品的特殊性，导致出货都比较麻烦，原厂需要结合客户的产品及年用量来评估，由于审核周期较长且审核严格，导致其价格也是逐渐上涨，这迫使许多国内客户不得不转向国产替代。ADI 的财年分界点是 11 月，代理商为了配合 ADI 下一个财年的业绩，把大部分的出货时间延迟到了 10 月底，故在这个时间之前需要出货的客户都需要都特批申请。

三星再次调涨存储芯片价格

三星再次调涨存储芯片价格，正式宣告行业全面进入上升周期。近期，三星电子已通知核心客户计划第四季度调涨 DRAM 和 NAND Flash 的合约价格。其中 LPDDR4X、LPDDR5/5X 等移动 DRAM 价格涨幅预计达 15%至 30%，eMMC、UFS 等 NAND 产品价格也将上调 5%至 10%。

镁光产能吃紧致使价格上涨 30%

镁光本月整体产品涨幅达 30-40%，取消了协议价，且中间暂停报价一周。据了解，镁光涨价的主要原因是产能吃紧，高端系列的 HBM 产能严重不足，LPDDR3 和 LPDDR4 的产能已经排满，预计后续还会持续涨价的同时原厂还会与客户签订 NCNR 协议。镁光第四季度财报显示 EPS 呈翻倍增长，主要是 HBM 的营收创新高，镁光 HBM 客户扩大至 6 家，未来几个月，2026 年的 HBM 产能也将被订满，其他产品的交期恐会被拉长。镁光全年营收为 373.78 亿美元，相比于上个财年的 251.11 亿美元大幅度提升，增长了 48.85%，创下全年营收纪录；DRAM 产品的营收增长了 62%，增至 286 亿美元，占美光总收入的 76%；NAND 闪存产品的营收增长了 18%，增至 85 亿美元，占美光总收入的 23%；净利润为 85.39 亿美元，上一财年净利润为 7.78 亿美元；毛利率为 39.8%。

SanDisk 所有渠道产品价格上涨 10%

9 月 SanDisk 表示正看到市场对于闪存产品的强劲需求，故宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调 10%以上。为了确保提供高性能闪存解决方案并支持持续的创新投资，目前 SanDisk 正在对闪存产品组合进行价格调整，SanDisk 表示，这些调整仅适用于新的报价和订单，并不适用于现有的承诺。未来将继续定期进行价格评估，并可能在未来几个季度进行其他调整。

瑞萨近期停产多个型号的传感器

瑞萨近期调整较多，9 月有许多型号的传感器停产。新晔反馈，瑞萨预计停掉整个传感器产线，但这一消息与其他代理商的反馈并不一致，也有代理商反馈说并不会停掉整个产线。瑞萨的射频产线在 2024 年就卖给了一家印度公司，目前仅剩中电港一家代理商在售该产品，后续中电港是否会继续代理这块产品尚待确认。RAA 系列因为用在 AI 上，故交期已经已经被延长至 20 周左右，且部分型号已出现缺货情况。整体来看，瑞萨今年在国内的市场份额是有增长的，但海外的下降。瑞萨在车规方面市场份额有所增长，家电领域占比却有所下降，大部分都已经被国产品牌替代。

瑞昱已完成今年业绩目标

代理商反馈瑞昱今年的业绩目标都已完成，目前原厂正在控制出货量，有意拉动价格上涨。目前有收到客户的反馈，原本与原厂下单的一批货最后也只收到少量，原厂有意将交期延迟至明年 Q1。如 RTL8211FI-CG 因交期拉长价格从 7.5 元涨到 12.8 元，但客户的接受程度普遍偏低。

TI 月市场需求平稳，价格小幅上涨

TI 9 月涨价并没有预期高，整体影响不大。市场反馈 TI 9 月的订单量没有什么变化，客户端的需求并没有很多。TI 的反倾销调查，主要涉及 40nm 及以上工艺通用接口芯片和栅极驱动芯片，接口芯片主要有 CAN 接口芯片 SN65HVD230 231 等，用于汽车和其他工业产品信号发送和接收，RS485 芯片，MAX485, UART 接口芯片，TM4C123GH6PM, SPI 接口芯片，I2C 接口芯片。

恩智浦任命新大中华区销售与市场资深副总裁

近日，恩智浦半导体宣布，任命胡煜华女士（Sandy Hu）为大中华区销售与市场资深副总裁，向恩智浦执行副总裁、中国事业部总经理李晓鹤先生汇报。胡煜华女士将全面负责大中华区的市场与销售工作，聚焦市场策略转型与生态合作的拓展，带领团队更精准地洞察客户需求，加速本地协同创新步伐，为客户创造更大价值。

英飞凌汽车物料需求下降

8 月份英飞凌汽车料的需求大幅下降，SAK 系列市场价格大幅下跌。IGBT 目前仍普遍缺货，交货周期一般在 40 周以上，这使得其价格维持在高位；而 MOSFET 方面，公开市场上有大量库存，但总体需求疲软，部分低压型号已出现市场价格倒挂，如 IRF250NPB、IRF2804PBE，不过部分高压 MOSFET 依旧处于价格高位。8 位、16 位 MCU 产品交期已基本恢复至 12 - 30 周，但 IGBT 交货周期一般在 40 周以上，反映出不同产品在供应上的差异。英飞凌部分产品有明确的计划供应时间，如 IAUAN04S7N007 汽车级 MOSFET 预计至少在 2038 年前都有供应，S25FL128SDSMFV001 Quad SPI 闪存预计至少在 2033 年前有供应。

东芝持续在汽车、工业和 AI 领域发力

TOSHIBA 主要分为两大类，光耦和功率器件 MOSFET。东芝电子元件的功率半导体产品兼具高功率密度与质量稳定性，通过提升功率转换效率，为减少环境负荷做出了贡献。其中，SiC MOSFET 第三代兼具低导通电阻与高可靠性，而 IGBT 则具有大电流与高可靠性，两者均拥有丰富的市场应用案例。TOSHIBA 主要客户领域还是工控和汽车为主，TOSHIBA 在中国市场的份额占比是 20%，海外和本土占比大，持续在汽车、工业和 AI 领域发力。

物美价廉，光宝已实现多领域多品牌的可替代方案

光宝的核心业务聚焦 AI、云端运算及新能源领域，在新能源领域，光宝的 1500V 加强绝缘光耦和 3300V 光学继电器可直接替代博通、安森美的产品；推出的 100Mbps 电容式隔离器（如 LTV-817 系列）可替代安森美、TI 的同类产品，延迟 < 5ns，成本低 20%；在工业自动化领域已批量应用于汇川技术、禾川科技的 PLC 系统；在智能家居领域，光宝的 MOC3052-A 双向可控硅光耦可替代东芝 TLP3624，价格低 30%，供货周期缩短至 4-6 周。光宝科技的替代方案集中在高壁垒、高增长赛道，通过技术整合、产能分散、成本优化三大策略，在 AI 服务器电源（替代台达）、高压光耦（替代博通）、液冷散热（替代 Vertiv）、汽车照明（替代欧司朗）等领域形成差异化竞争力。目前价格相对稳定，交期一般在 6-10 周，近期低价的物料不再降价。

英特尔小核 CPU 因产线切换导致缺货

从 7 月的裁员到现在的工厂切换产能，英特尔小核 CPU 正在经历产线切换的过程，导致小核 CPU 近期出现了缺货的情况，I7、I5 系列价格受影响较大，几乎一天一个价，到货也比较困难，这种情况预计持续到 2026 年初。

铠侠 Q4 价格上涨，产能依旧吃紧

铠侠 Q4 相较 Q3 涨价 10-15%，eMMC 的产能依旧吃紧，主要体现在 4G、8G 上。铠侠一直都是提前一个季度发布 FCST，然后锁定季度价格，主要服务一些大客户。铠侠目前已放弃中小客户，集中产能保障大客

户的供应，故现货市场上稍有铠侠的产品流通。且铠侠也没有所谓的市场价，不同于三星和海力士的买断制，铠侠是代理商模式，铠侠与重点客户直接谈价格然后再通过代理商供货，所以价格和利润基本是定死的。

广瀚电机严查串货情况

广瀚机电近期在严管串货情况，主要原因是原厂在逐步规范渠道与价格体系，打击非授权流通，保障合理利润与对应成本，同时也希望通过次来优化资源分配与战略聚焦，目前广瀚将重新注重新能源汽车、AI 服务器、人形机器人及折叠手机等领域。

华邦电子新品 CUBE 预计 2026 年实现营收

CUBE (Customized Ultra-Bandwidth Elements) 是华邦电子专为边缘计算市场打造的半定制化超高带宽元件，凭借中小容量、超高带宽、低功耗、小尺寸、低成本的优势，完美填补了标准 DRAM 与 HBM 之间的市场空白，为边缘设备运行人工智能提供理想内存解决方案，助力客户在边缘 AI 领域实现差异化发展。预计 2026 年逐步贡献营收，期待 2028 年该产品营收可占其 DRAM 事业的 40%。CUBE 最初将用于挖矿应用领域，后续将延伸至监控摄影、穿戴设备等 AI 边缘运算场景。据华邦电子介绍，CUBE 通过 DDR3 垂直堆叠设计，可堆叠出类似 HBM 效果，带宽甚至可超越 HBM4。现在华邦电子大客户的价格还是比较稳定，原厂有想给中小型客户涨价，尚在谈判阶段。目前 128 系列仍在缺货状态，每月只有少量现货，交期普遍在 6-10 周，波动较大。

艾为电子目前价格稳定，交期正常

AWINIC 艾为电子的产品广泛应用于消费电子、工业互联和汽车市场。在消费电子领域，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、智能音箱、家电等；在工业互联领域，应用于工业自动化、智慧安防等；在汽车电子领域，如车规级音频功放、氛围灯驱动芯片等。对标品牌主要有 SGM 和 3PEAK。通用物料代理商和原厂会备库存，正常订货交期 8 周左右，价格稳定。

行业趋势

SEMI：到 2028 年中国将占据全球芯片制造产能的 42%

全球半导体行业正在进入由人工智能驱动的前所未有的增长阶段，市场预测到 2030 年该行业规模将超过 1 万亿美元。

人工智能重塑全球半导体竞争

在北京举行的 2025 IC WORLD 大会上，SEMI 中国区新任总裁冯莉莉表示，人工智能正在加速半导体行业的增长，并重塑全球投资和技术竞争格局。她指出，在政策和资本的支持下，中国正在扩大晶圆制造规模，并实现设备和材料的国产化，以巩固其在主流工艺节点上的地位。

冯女士首次以 SEMI 中国区总裁的身份亮相 IC WORLD，并发表了题为“人工智能时代的全球及中国半导体展望”的主题演讲。

市场增长加速，迈向万亿美元里程碑

冯博士表示，2024 年全球半导体销售额将达到 6305 亿美元，同比增长 19.7%。预计 2025 年将再增长 11.2%，超过 7000 亿美元。她强调，与该行业从 2000 年的 2000 亿美元缓慢增长到 2013 年的 3000 亿美元相比，这一增长速度显著加快。她指出，自 2020 年以来，人工智能对服务器、数据中心和存储的需求已成为关键的增长动力。

到 2030 年，人工智能基础设施相关的半导体市场规模预计将达到 3400 亿美元，占整个市场的 34%，是 2024 年 1490 亿美元的两倍多。GPU 将成为核心，其市场规模将从 2025 年的 1000 亿美元增长到 2030 年的 3260 亿美元，成为这个万亿美元市场的主要驱动力。

国家战略引发投资热潮

冯指出，世界各国政府如今都将半导体视为战略资产。美国公布了一项耗资 5000 亿美元的人工智能基础设施计划——“星际之门计划”。《欧洲芯片法案》提供了超过 500 亿欧元（约合 587 亿美元）的资金。韩国推出了 4500 亿美元的“K-半导体战略”，而日本则设立了后 5G 基金，并提供补贴以支持国内项目并吸引台积电。

中国于 2024 年启动国家集成电路产业基金第三期，进一步加强了其长期自给自足的努力。该基金注册资本为 3440 亿元人民币（482 亿美元），超过了前两期的总和，期限延长至 15 年。

运力向亚太地区转移

全球产能分布急剧变化。2000 年，日本和美国占据了全球晶圆产量的 50% 以上，而中国大陆仅占 2%。到 2010 年，中国大陆的份额上升至 9%，韩国和台湾合计占比 35%。到 2020 年，中国大陆的份额达到 17%。

SEMI 预测，到 2026 年，中国大陆 12 英寸晶圆厂产能将上升至 26%，与台湾和韩国并列成为全球三大投资中心之一。

中国加倍押注主流节点

2021 年，全球晶圆厂设备支出超过 1000 亿美元，并保持高位。SEMI 预测，2026 年至 2028 年期间，年度支出将超过 1200 亿美元，其中人工智能和高性能计算（HPC）相关投资占比将从 2025 年的 40% 上升至 2028 年的 48%，主要集中在 7 纳米以下逻辑和先进存储器领域。

中国的设备投资稳步增长，2024 年占全球支出的 40% 以上，预计 2025 年将达到 380 亿美元。中国目前占亚太半导体市场的 46%，占全球市场的 24%。2023 年，中国集成电路产业销售额达 1.227 万亿元人民币，预计 2024 年将超过 1.3 万亿元人民币，增幅超过 5%。

2024 年至 2028 年，中国晶圆厂产能预计将以 8.1% 的复合年增长率增长，其中 22 纳米至 40 纳米节点的复合年增长率将达到 26.5%。SEMI 预计，中国在全球主流节点产能中的份额将从 2024 年的 25% 攀升至 2028 年的 42%。

研发差距仍然是战略障碍

尽管增长强劲，但半导体资本支出仍然集中。预计 2025 年支出将达到 1600 亿美元，其中台积电、三星和英特尔合计占比 57%，前五大公司则超过 70%。

中美之间的研发差距仍然巨大。2022 年，美国企业研发支出为 588 亿美元，相当于销售额的 18.75%，而中国仅为 7.6%。冯军表示，中国必须加大研发投入，确保核心技术突破，才能缩小与全球领先企业的差距。

汽车芯片市场增长速度是汽车市场的 5 倍

Yole 表示，汽车半导体市场将从 2024 年的 680 亿美元增长到 2030 年的 1320 亿美元，复合年增长率为 10%，比汽车市场增长速度快五倍。

前五大企业控制着一半的市场，但新兴挑战者正在重塑竞争格局。

英飞凌在 2024 年汽车收入将超过 80 亿美元，位居全球领先地位，紧随其后的是恩智浦和意法半导体。

美国公司在先进计算、模拟和存储领域占据主导地位，占有 36% 的市场份额。

中国供应商在国家政策支持下，在座舱、ADAS、功率 SiC 等领域进展迅速。

包括特斯拉、比亚迪和蔚来在内的原始设备制造商正在进行垂直整合，颠覆传统的供应链。

台积电和三星保持着对 16nm 以下汽车节点的控制，并将在 2027 年之前完全分配。

汽车市场相对增长（2024 年至 2030 年期间复合年增长率为 2%）和汽车芯片市场同期复合年增长率为 10%证明了汽车转变为软件定义电子平台的速度。

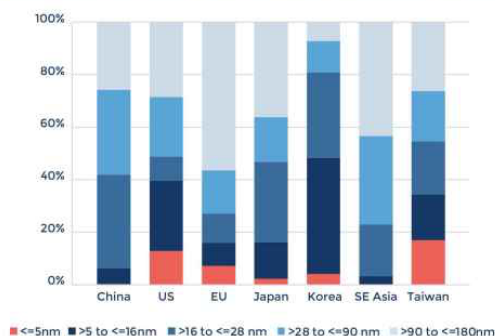
汽车半导体厂商正在积极布局，以在这个快速扩张的市场中获取价值。

一些公司正在加强其在电源管理、电气化和安全系统方面的地位，而另一些公司则在推动 ADAS、信息娱乐和激光雷达计算平台的进步；例如，中国正在将激光雷达作为其国内电动汽车竞赛中的差异化因素。

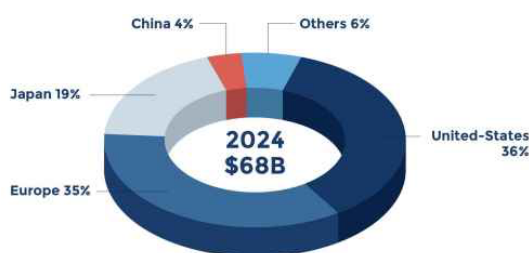
AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR INDUSTRY

Source : Automotive White Paper, Vol.2, Yole Group

Automotive semiconductor trends -
2030 wafer capacity per month by node & by region



2024 Automotive semiconductor industry
by region* (HQ)



www.yolegroup.com | ©Yole Group 2025

全球竞争格局正在发生变化。美国和欧洲企业继续利用规模、知识产权深度和已建立的原始设备制造商关系来捍卫领先地位。

与此同时，在国家支持的推动下，中国企业正在积极建设能力，以确保自给自足的半导体生态系统。

与此同时，特斯拉、比亚迪、蔚来等主机厂正在加速垂直整合，进一步颠覆传统供应链，重塑整个生态系统的价值获取方式。

然而挑战依然存在：地缘政治风险、人工智能驱动的计算需求以及向集中式车辆平台的架构转变将考验整个供应链的弹性。

Yole 的 Pierrick Boulay 表示：“汽车半导体不再是隐形的推动者，而是未来出行的基础。未来五年的技术选择和战略押注将决定这个行业的胜负。”

节点演进和芯片设计兴起对供应安全和创新产生了影响。由于台积电和三星的 16 纳米以下工艺产能已满至 2027 年，因此产能可用性以及与汽车制造商的战略协调至关重要。

政策影响

《新跨大西洋贸易协议》影响报告

近日，全球电子协会发布了关于新跨大西洋贸易协定对欧洲电子行业的影响报告。

2025 年 7 月 27 日，欧盟与美国就关税和贸易达成政治协议。跨大西洋伙伴关系是全球贸易的重要脉络，也是全球最重要的双边贸易和投资关系。过去十年，欧盟与美国的商品和服务贸易额翻了一番，2024 年超过 1.6 万亿欧元。根据该协议，欧盟-美国关税框架自 2025 年 8 月 1 日起，将对欧盟大部分电子产品出口征收 15% 的统一美国关税，这将导致跨大西洋贸易成本可预测但结构性上升。

报告指出，新的跨大西洋关税格局给欧洲电子行业带来了重大变化，脱离世贸组织最惠国待遇的公平竞争环境带来了新的竞争调整：进入美国市场时面临直接和间接的关税压力，而美国商品进入欧盟则被取消关税。此外，一些国家现在享有美国关税的先发优势，进一步限制了欧洲制造商的发展。

下载详细报告: [《The New Transatlantic Trade Agreement》](#)

高风险物料预警

Part Number	Manufacturer
BLL1214-35	NXP SEMICONDUCTORS
7260HMW	INTEL CORP
BCM56636B0KFSBG	BROADCOM CORP
CD4050BF/3	RCA SOLID STATE
CD4050BF/3	HARRIS SEMICONDUCTOR
LC7093-64B	LOYTEC AMERICAS
CSACV16M0X55Q-R0	MURATA MANUFACTURING CO LTD
N82S100F	SIGNETICS CORP

注：该部分数据来源于 ERAI，仅供参考。